

ウイスカ及び実装材料研究会

◆ 目的・スコープ

- ウイスカ発生に関わる試験方法のIECやJIS規格・事例収集の制定・改正実施。
- 研究会の組織特徴を活用し、将来の実装、部品、素材について調査し、実装課題と次に定めるべき方向性を提案する。

◆ 活動の概要

- 実装技術標準化専門委員会では、2001年度からの経済産業省の基準認証研究開発事業『高密度実装における接合の信頼性等に関する標準化』、2006年度からのSAPOINテーマ『電子実装の信頼性向上のためのウイスカ防止技術の開発』などを経て、IEC規格IEC 60068-2-82“Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test XW1: Whisker test methods for electronic and electric components”やJEITA ET-7305「錫ウイスカ抑制鉛フリー材料選定のガイドライン」の制定などのウイスカに関わる問題に対して、世界に先駆けて取り組んできた。
- この取り組みは、国内の電子部品実装、電子部品、はんだ・めっき・金属材料・加工メーカー及び研究機関の27を超える数の組織が集まるユニークな（「Connected Industries」の状態を）構成した活動となっている。ここから、ウイスカだけでなく、様々な観点で「未来の実装の基幹となる材料に関する問題についても考える」ものとして、「ウイスカ及び実装材料研究会」と名称を変えて活動を行なっている。

◆ 担当する規格

IEC国際規格	対応JIS	JEITA規格	名称
IEC 60068-2-82 (2007年制定、 19年改訂)	JIS C 60068-2-82と して2009年に発 行し、21年改訂。	---	電気・電子部品のウィスカ試験方法
---	---	ET-7305	錫ウィスカ抑制鉛フリー材料選定ガイド ンス
		ET-7035	低温実装におけるSnウィスカの発生の 調査研究の中間報告